



# 中華民國專利證書

發明第 1 232569 號

發明名稱：應用預設定量金屬球製作半導體電路元件之金屬鍵結之方法

專利權人：典琦科技股份有限公司

發明人：楊成誠、陳文隆、蔡耀煌、胡志良、陳炳南

專利權期間：自2005年5月11日至2023年3月20日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長 蔡練生

中華民國

94



5

月

11

日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿之次日起消滅。